

Title (en)

Wire connecting device for low current installations.

Title (de)

Leiteranschlussvorrichtung für Schwachstromanlagen.

Title (fr)

Dispositif de connexion de fils notamment pour des installation à courant faible.

Publication

EP 0650217 A1 19950426 (DE)

Application

EP 94115712 A 19941006

Priority

CH 314093 A 19931018

Abstract (en)

The wire (conductor) connecting device for weak-current installations, having means for solder-free wire connection, comprises at least one longitudinal channel (2), for accommodating a wire (30), on a housing part (1). In this case, each longitudinal channel (2) interacts in its axial direction with a contact region (6), which extends tangentially with respect to the inserted wire, of a contact pin (16), and with at least one clamping pin (7), which likewise extends tangentially with respect to the inserted wire. The contact region (6) of the contact pin (16) and the clamping pin (7) in this case project into the longitudinal channel (2) in such a manner that, when the wire (30) is inserted, a predetermined contact pressure can be produced on the stripped region of the said wire (30). <IMAGE>

Abstract (de)

Die Leiteranschlussvorrichtung für Schwachstrom-Anlagen, mit Mitteln zur lötfreien Andrahtung umfasst an einem Gehäuseteil (1) mindestens einen Längskanal (2) zur Aufnahme eines Leiters (30). Hierbei wirkt jeder Längskanal (2) in seiner axialen Richtung mit einem sich tangential zum eingelegten Leiter erstreckenden Kontaktbereich (6) eines Kontaktpins (16) sowie mit mindestens einem sich ebenfalls tangential zum eingelegten Leiter erstreckenden Klemmstift (7) zusammen. Der Kontaktbereich (6) des Kontaktpins (16) sowie der Klemmstift (7) ragen dabei derart in den Längskanal (2) hinein, dass bei eingelegtem Leiter (30) auf dessen abisolierten Bereich ein vorgegebener Kontaktdruck herstellbar ist. <IMAGE>

IPC 1-7

H01R 4/24

IPC 8 full level

H01R 4/24 (2006.01)

CPC (source: EP KR US)

H01R 4/24 (2013.01 - KR); **H01R 4/2406** (2017.12 - EP US); **H01R 4/2433** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [Y] DE 2912882 A1 19801002 - SIEMENS AG
- [Y] BE 463577 A
- [A] GB 1454936 A 19761110 - FRANKLIN C, et al
- [A] US 4039239 A 19770802 - COBAUGH ROBERT FRANKLIN, et al
- [A] NL 67298 A

Designated contracting state (EPC)

CH DE FR GB IT LI

DOCDB simple family (publication)

EP 0650217 A1 19950426; **EP 0650217 B1 19980520**; AU 680045 B2 19970717; AU 7595094 A 19950504; BR 9404130 A 19950718; CH 687113 A5 19960913; CN 1106955 A 19950816; DE 59406005 D1 19980625; JP H07249437 A 19950926; KR 950012804 A 19950517; PL 305480 A1 19950502; TW 256955 B 19950911; US 5573421 A 19961112

DOCDB simple family (application)

EP 94115712 A 19941006; AU 7595094 A 19941018; BR 9404130 A 19941017; CH 314093 A 19931018; CN 94117261 A 19941018; DE 59406005 T 19941006; JP 25093994 A 19941017; KR 19940026490 A 19941017; PL 30548094 A 19941017; TW 83109474 A 19941013; US 32232794 A 19941013